

PA-HM01

厚膜铂银导体浆料

产品介绍

PA-HM01铂银导体是一种基于银的低成本多层体系。它旨在通过丝网印刷应用于陶瓷基板，并在链式炉中在氧化气氛(空气)下烧结，以形成互连导体和元件附着焊盘。PA-HM01还可以用作内层和顶层导体。

产品特点

极佳的可焊性。

对杜邦介质有良好的附着力。

高导电性

不含镉和铅*

典型性能

性能	指标
粘度 ¹ (Pa.s, 5 rpm, 25°C)	200 - 300
印刷面积 (cm ² /gram)	50 - 80
分辨率 (um, dried)	100 / 100
烧结膜厚 (um)	6 -9
方阻 (mΩ /sq)	≤ 4 @16um 烧结厚度
¹ Brookfield HBD 52Zcone	

推荐工艺

基板: PA-HM01性能是基于 96%氧化铝基板的测试。其他成分的基板和不同制造商的基板可能会导致性能属性的变化。

印刷: 推荐使用 280-325 目不锈钢丝网，乳胶厚度 10-15 μm。印刷速度可达 10-50 厘米/秒。印刷应该在清洁通风的环境中经行，在 20-23°C 环境中印刷浆料具有最佳的印刷性能。

干燥: 浆料印刷后，在室温下流平5-10分钟，然后在通风的烘箱或传送带式干燥炉中150°C干燥 10-15 分钟。

烧结: 烧结在具有通气的链式烧结炉中进行，使用60分钟周期烧结曲线，峰值温度850°C，10分钟。

存储和有效期: 浆料应在密闭的容器中清洁、温度稳定的环境中保存，温度小于 25°C。在没有打开容器的情况下，保质期为发货日期 6 个月。长时间存放可能会发生固体物沉降，使用前进行充分搅拌。

安全与处理: 本产品含有有机溶剂和材料，在使用PA-HM01时应采取以下预防措施：

在有足够通风的情况下使用；

避免长时间接触皮肤避免长时间吸入蒸汽；

如接触皮肤，应立即用肥皂和水清洗患处；

吞食有危险；